

檔 號：

保存年限：

台灣發明協會 函

地址：241608新北市三重區重陽路一段1號4樓之11

承辦人：秘書處 吳秋瑾

電話：02-66057626

電子信箱：tia7626@yahoo.com.tw

受文者：國立臺北護理健康大學

發文日期：中華民國115年3月23日

發文字號：台發協字第1150003022號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2026美國矽谷國際發明展簡章 1.邀請函2.報名表3.切結書(0003022A00_ATTCH12.pdf、0003022A00_ATTCH13.doc、0003022A00_ATTCH14.doc)

主旨：敬邀貴校參加「2026美國矽谷國際發明展」，請協助轉知師生踴躍報名參加。

說明：

- 一、2026美國矽谷國際發明展（SVIIF 2026）即將在8月開展，敬邀貴校師生參與，請惠予公告並鼓勵師生踴躍參加，以提倡發明創新風氣，並為國爭取最高榮譽。
- 二、主辦大會：國際發明聯盟總會(IFIA)。台灣授權單位：台灣發明協會
- 三、參展日期、地點：2026年8月14日~8月16日，美國聖克拉拉會議中心舉行，共為期3天。
- 四、即日起報名至2026年5月30日截止。(參賽簡章請參考附件)
- 五、報名相關問題歡迎洽詢本會承辦人：秘書處 吳秋瑾 小姐。電話：(02)6605-7626。電子郵件：tia7626@yahoo.com.tw。歡迎透過 LINE 官方好友：@tia1972 與我們聯繫。

正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大

研究發展處 115/03/24



1150004051

學、國立臺灣藝術大學、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學、佛教慈濟醫療財團法人關山慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人玉里慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人斗六慈濟醫院、佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、板橋國泰醫院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院附設居家護理所、輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院、亞洲大學附屬醫院、國泰醫療財團法人國泰綜合醫院、國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院、國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院、國立嘉義大學附設實驗國民小學、高雄榮民總醫院、臺北榮民總醫院、恩慈美國學校、新竹美國學校、桃園美國學校、國立成功大學、奇美醫療財團法人奇美醫院、奇美醫療財團法人佳里奇美醫院、中華台北著作權人協會、華梵學校財團法人華梵大學、馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校、馬偕學校財團法人馬偕醫學大學

副本：

台灣發明協會 理事長 張家菊

電 2026/03/24 文
交 11:21:02 章

